

RainaPorting

芯片跨工艺迁移平台 — AI Agent + DTCO 闭环，加速跨工艺迁移与第二供应来源建设

客户的问题·我们的解法

痛点

供应链突变，量产芯片被迫换 Fab / 换工艺；传统迁移周期以月计、成本以百万计，高度依赖少数资深工程师——一个 spacing 差异就是几千个 DRC violation，一颗缺失的 PLL IP 就能卡死整个项目。

解法

把重复性、规则性、可脚本化的工作交给 AI Agent 与自动化流程；专家经验沉淀为可复用知识库；工程师聚焦 20% 真正需要判断的问题。每个项目的规则映射、修复经验、waiver 记录都成为下一次迁移的资产。

核心能力

AI Agent Orchestrator

Intake / PDK·Lib / Analysis / Flow Builder / Implementation / Signoff / Package 七类专业 Agent 闭环协作，全流程可追踪、可回放、可审计

DTCO 协同优化闭环

不止“搬过去”：单元库结构、VT 组合、PDN、SRAM 配置与 PPA 建模放进同一闭环迭代，保证新工艺上的性能、功耗、面积竞争力

多模态版图 AI

CNN / GNN / Transformer 结构理解 + 生成式自动化：跨命名、跨 Foundry 检索功能等价单元，自动生成 SKILL 脚本驱动 pcell 与版图迁移

工作流程



为什么选RainaPorting

· 对比传统人工 Porting

不依赖少数“活字典”，周期从数月压向 1 个月量级

· 对比一次性设计服务

知识库与 Silicon Library 归客户复用，二次迁移边际成本递减

· 对比“一键转换”工具

sequential cell 与复杂模拟结构由专家把关，全部结果经完整 signoff 验证。



网址：www.raina.tech

唐女士：☎ 13357509009
✉ tanghuifen@raina.tech

杨先生：☎ 13917427467
✉ yanglong@raina.tech